



Okamoto

株式会社岡本工作機械製作所
(証券コード：6125)

2026年3月期 決算説明会資料

2026年6月15日



アジェンダ

**1. 2026年3月期決算概況と
2027年3月期業績予想**

**2. 中期経営計画“INFINITY700”
進捗状況**

Appendix

1. 2026年3月期決算概況と 2027年3月期業績予想

決算サマリ

業績

- ✓ 売上高425億13百万円、営業利益15億18百万円
- ✓ 売上高は半導体関連装置が前年同期を上回るも、前期好調だった国内での大型平面研削盤の販売減少の影響などから前年に届かず

受注実績

- ✓ 半導体関連装置は国内や東アジア向けにファイナルポリッシャーの受注を獲得、前年同期を上回る
- ✓ 国内の工作機械は各種補助金の後押しもあり、小型および中型の平面研削盤の更新需要があり受注は前年同期を上回る。ロボット向けに精密歯車の受注も好調
- ✓ 海外では米国は航空宇宙産業を中心とした設備投資需要などから前年を上回る受注を獲得。欧州は景気停滞の影響などから受注は前年を下回る
- ✓ 中国は産業機械、金型、半導体装置向け中心に大型研削盤の受注が好調に推移

市場概況

■ 国内市場

- 工作機械は中小企業の設備投資を支援する補助金の効果もあり、小型及び中型平面研削盤の更新需要を取り込む。ロボット向け精密歯車も需要が高まり好調。一方で前年同期好調だった大型平面研削盤の販売は減少
- 半導体はシリコンウェーハの在庫調整正常化に向けた変化の兆しのなか、先端パッケージPLP向け加工装置など次世代分野への関心が高まる。次世代新機種開発などの施策を推進し、化合物半導体加工用およびウェーハ生産用ファイナルポリッシュャー、グラインダを販売

■ 海外市場

- 北米は航空宇宙産業の設備投資の増加に加え、政府の優遇税制の影響もあり受注・売上とも前年を上回る
- 欧州は東欧で自動車産業向けの需要は見られたが、ドイツを中心に製造業の回復が遅れ景気が停滞、受注・売上とも前年を下回る
- 中国では産業機械、金型、半導体装置向けを中心に大型平面研削盤の受注が好調に推移。受注・販売とも前年を上回る
- 半導体は国内、東アジア向けに化合物半導体加工用およびウェーハ生産用のファイナルポリッシュャーやグラインダを販売、前年を上回る

業績ハイライト

(単位：百万円)

	2025年3月	2026年3月	
	金額	金額	前期比増減率
売上高	43,734	42,513	▲2.8%
売上総利益	12,828	11,436	▲10.9%
販売費及び一般管理費	9,812	9,917	+1.1%
営業利益	3,015	1,518	▲49.6%
経常利益	2,916	1,535	▲47.4%
当期純利益	2,024	1,234	▲39.0%

※小数点第2位を四捨五入

(単位：百万円)

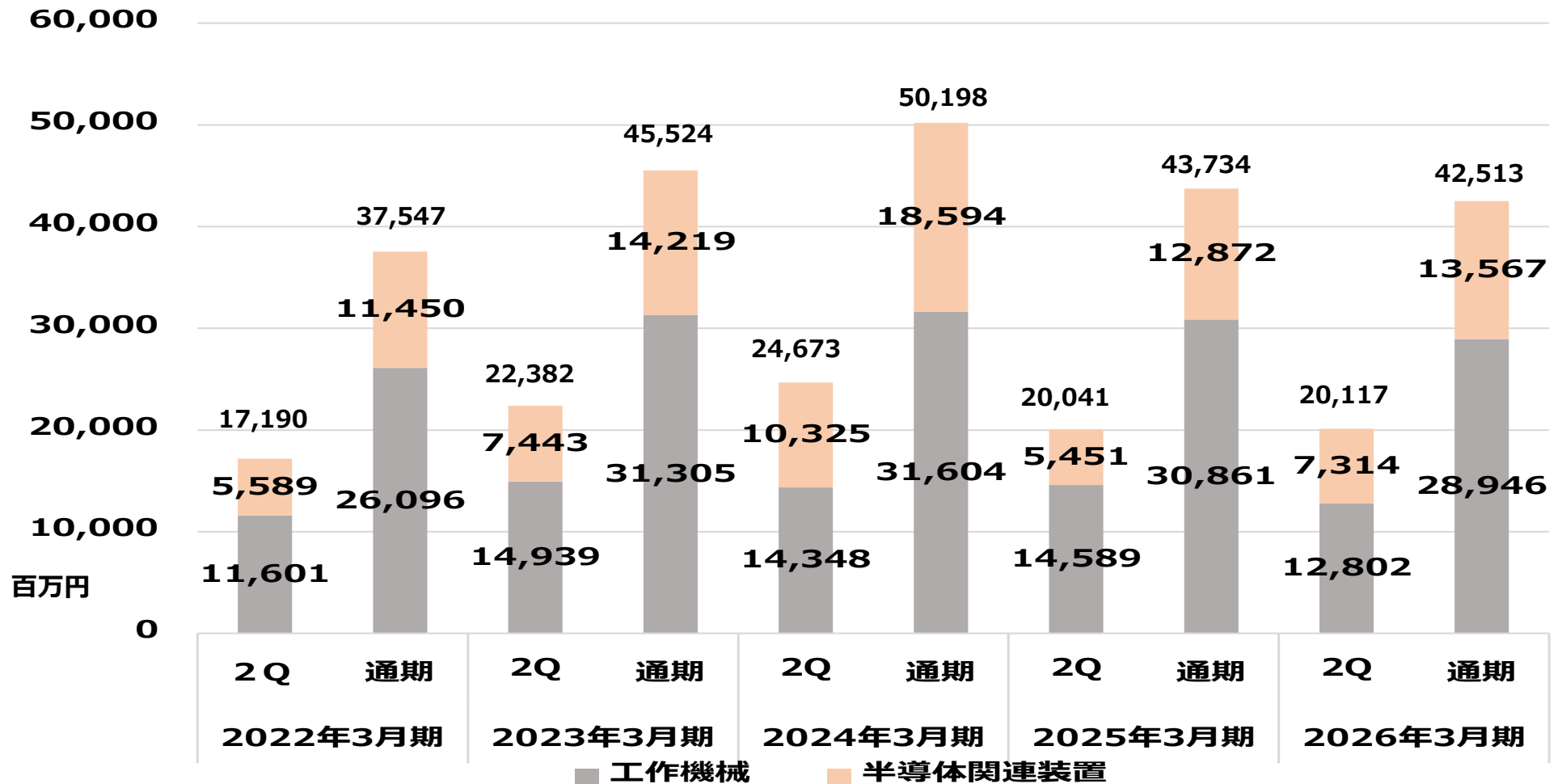
	2025年3月	2026年3月
	金額	金額
設備投資額	3,923	5,345
減価償却費	2,082	2,176
研究開発費	132	144

為替レート	2025年3月	2026年3月
米ドル	152.57	151.09
シンガポールドル	113.98	117.39
ユーロ	163.66	175.58
タイバーツ	4.40	4.68
人民元	21.12	21.35

※期中の平均レートで記載しております。

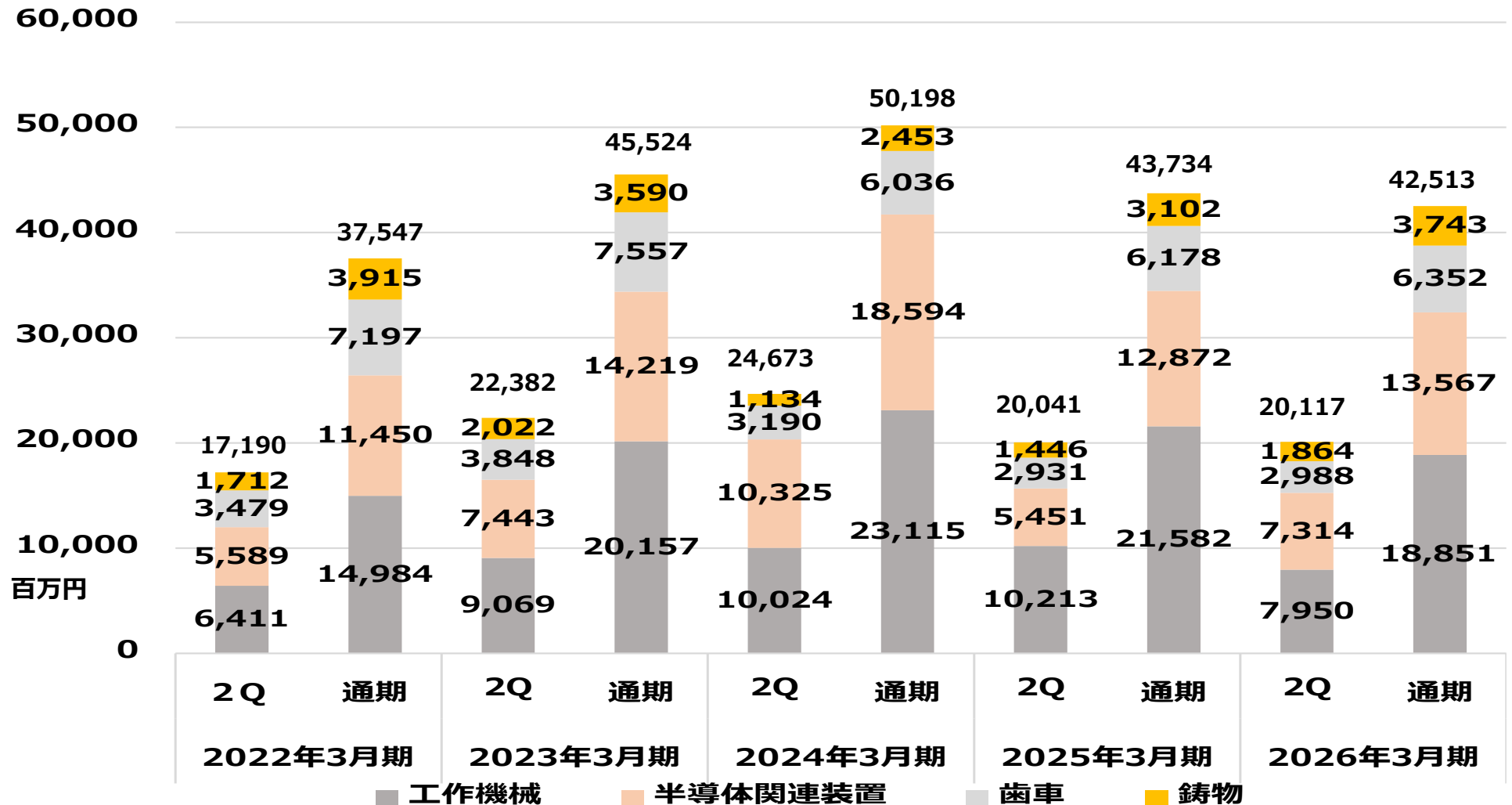
セグメント別売上高推移①

半導体関連装置の売上は前年同期を上回る



セグメント別売上高推移②

精密歯車、鋳物は売上が回復

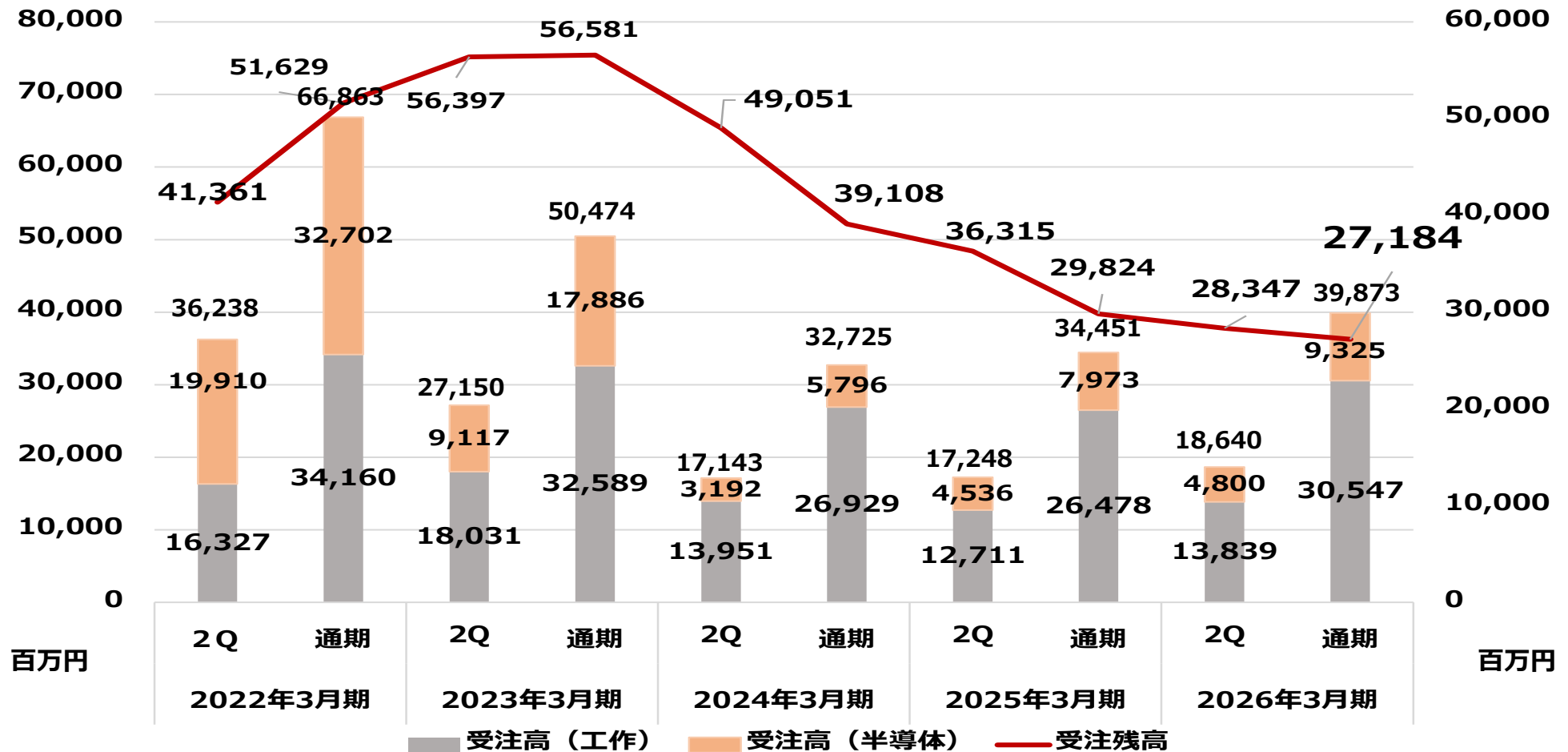


受注・受注残高

半導体関連装置の受注は回復傾向

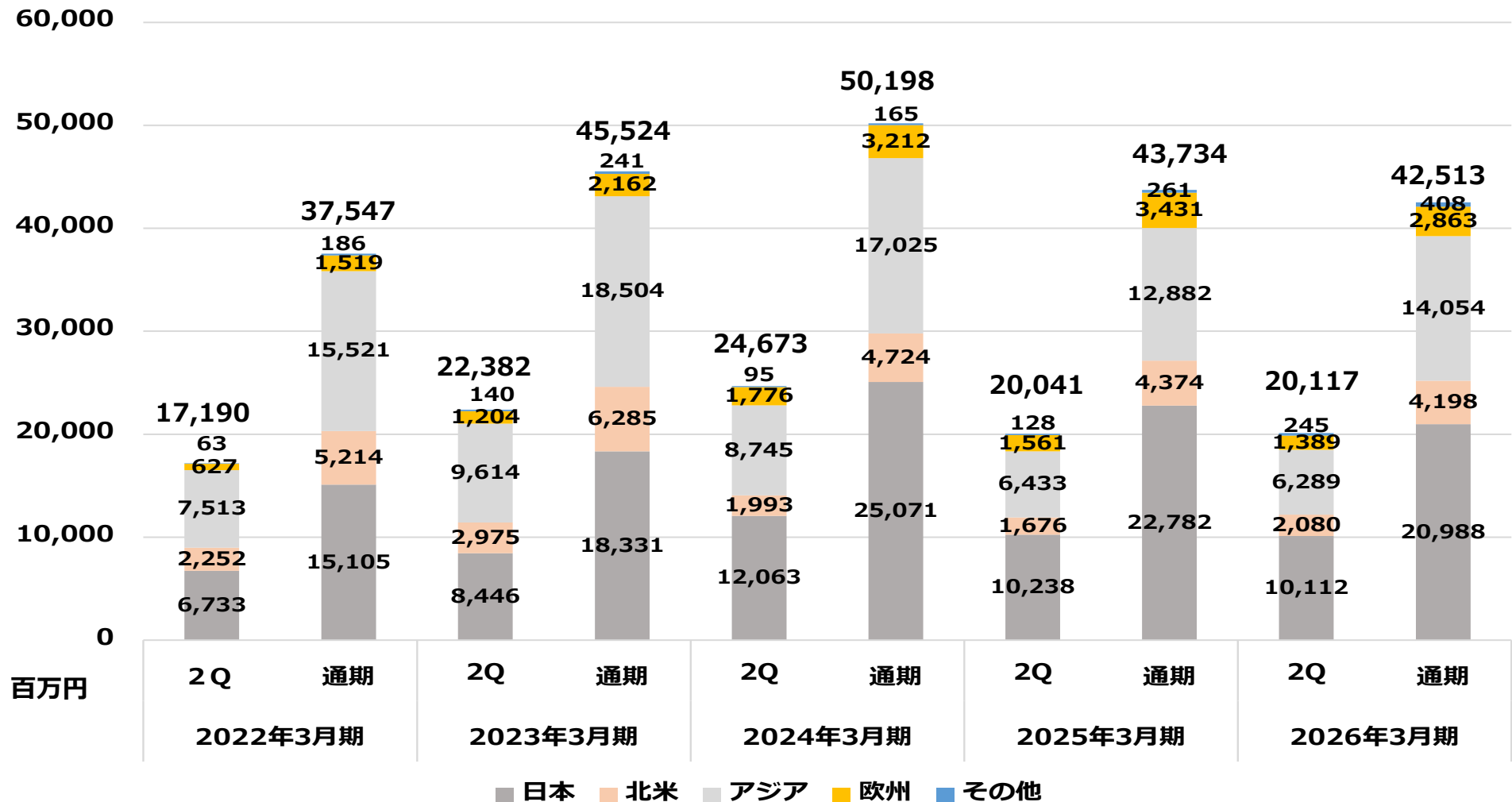
(受注高)

(受注残高)



エリア別売上高推移

中国は金型・半導体向けに門型平面研削盤が好調、前年を上回る



比較貸借対照表

(単位：百万円)

	2025年3月	2026年3月	
	金額	金額	対前期末比
流動資産	47,214	43,108	▲4,106
現金及び預金	9,899	12,227	+2,327
受取手形及び売掛金	11,156	9,489	▲1,667
その他	26,159	21,392	▲4,766
有形・無形固定資産	17,350	21,137	+3,786
投資等	2,239	2,952	+713
資産合計	66,804	67,198	+393

(単位：百万円)

	2025年3月	2026年3月	
	金額	金額	対前期末比
負債合計	26,241	24,545	▲1,696
流動負債	19,874	18,932	▲942
固定負債	6,366	5,613	▲753
純資産合計	40,563	42,652	+2,089
負債資本合計	66,804	67,198	+393

比較キャッシュフロー計算書

(単位：百万円)

	2025年3月	2026年3月	
	金額	金額	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲2,112	3,647	+5,759
税引前当期純利益	2,812	1,617	▲1,195
減価償却費	2,082	2,176	+93
売上債権の増減 (▲は増加)	1,167	1,977	+809
棚卸資産の増減 (▲は増加)	▲484	1,442	+1,926
仕入債務の増減 (▲は減少)	▲3,107	▲805	+2,302
その他	▲4,582	▲2,760	+1,822
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲5,095	▲3,312	+1,782
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,493	▲1,358	▲11,852
換算差額	17	628	+611
現金・現金同等物残高	14,722	14,327	▲394

2027年3月期業績予想

1期遅れるものの、2026年3月期に目標とした売上高500億円の達成を期す

(単位：百万円)

	2026年3月	2027年3月 (予想)	
	金額	金額	増減率
売上高	42,513	50,000	+17.6%
営業利益	1,518	3,000	+97.6%
経常利益	1,535	2,900	+88.9%
当期純利益	1,234	2,000	+62.0%

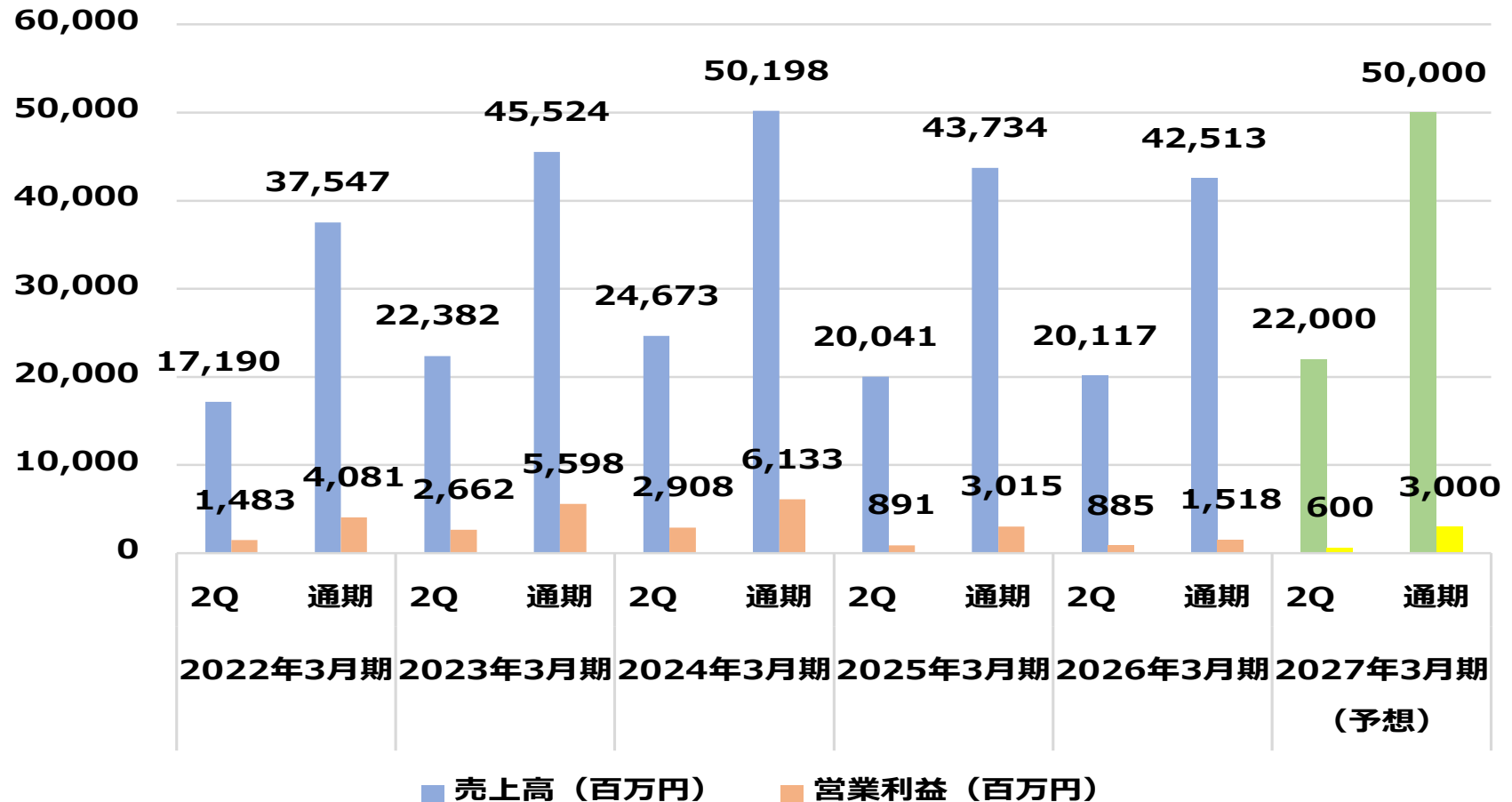
(単位：百万円)

	2026年3月	2027年3月 (予定)
	金額	金額
設備投資額	5,345	2,725
減価償却費	2,176	2,589
研究開発費	144	303
為替レート	2026年3月	2027年3月 (計画)
米ドル	151.09	150.00
シンガポールドル	117.39	115.00
ユーロ	175.58	169.00
タイバーツ	4.68	4.60
人民元	21.35	20.90

※期中の平均レートで記載しております

業績推移

基本的に下期に比重がかかる傾向



3. 中期経営計画“INFINITY700” 進捗状況

ビジョン2030と“INOFINITY”700

2023年11月、2030年にありたい姿として、中長期戦略「ビジョン2030」を発表
そこからバックキャストし2028年3月までの中期経営計画“INOFINITY700”を策定
4ヶ年計画の2年目を終える

ビジョン

世界に類のない「総合砥粒加工機メーカー」として、
平面研削盤・半導体ウェーハ研磨装置でグローバルNo.1を目指す

数値目標

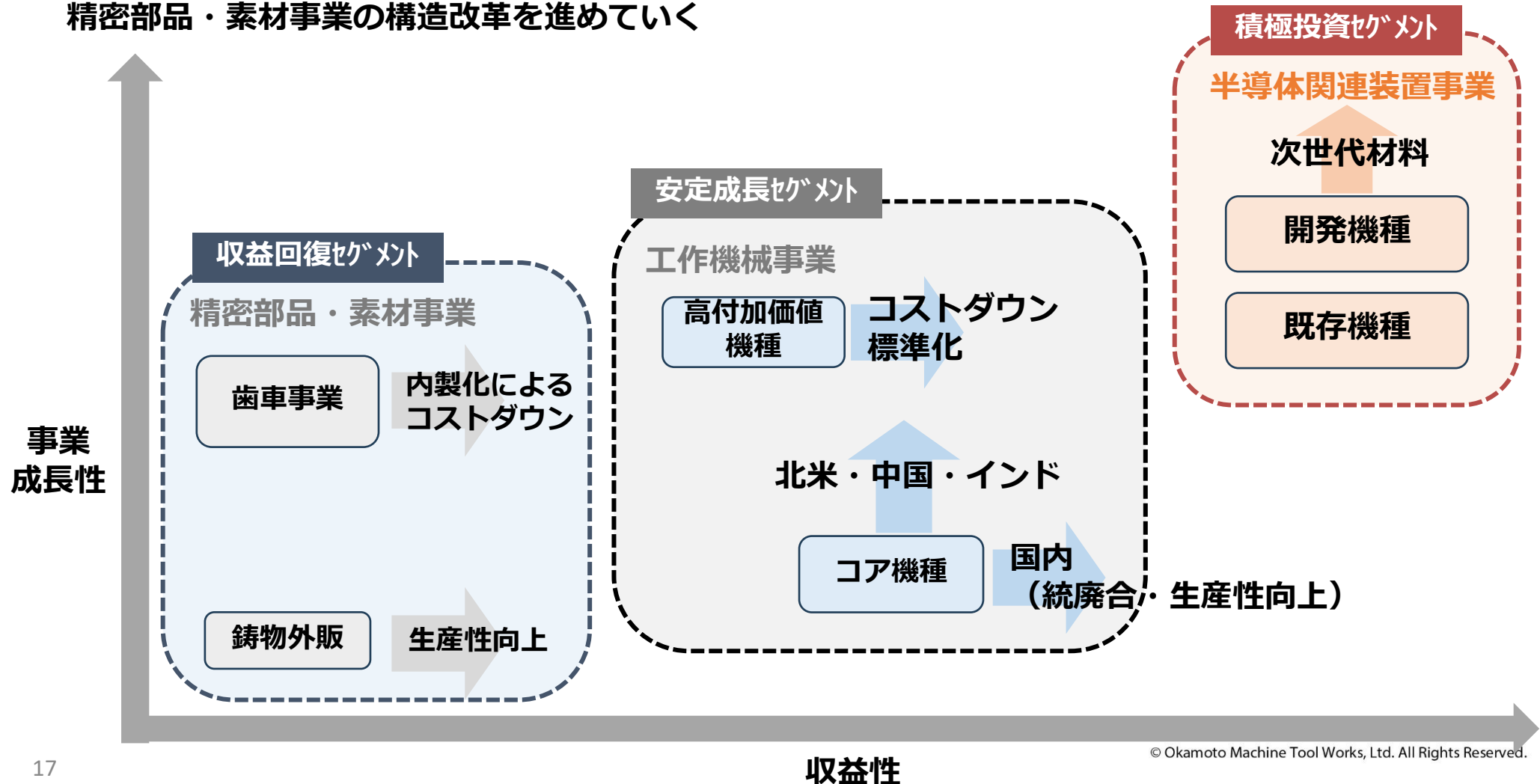
連結売上高：700億円 連結営業利益率：16%
ROE:17~18% 連結配当性向：45%以上

700
INOFINITY

INOFINITYは Innovation（革新）とInfinity（無限）を掛け合わせた造語
700は「ビジョン2030」の目標 売上高700億円から

中長期戦略 事業ポートフォリオ

- 中長期戦略では半導体関連装置事業を積極投資セグメントとして位置付け、次世代材料領域にて事業拡大を図る
- 工作機械事業では、収益性の高いコア機種での成長を図るとともに、高付加価値機種へのテコ入れ、精密部品・素材事業の構造改革を進めていく



半導体関連装置事業 中計戦略骨子

半導体 関連装置

I .成長投資の検証・実行管理

(成長投資の実行と管理)

II .半導体関連装置事業の収益力維持・向上

(先行開発、新市場開拓・シェア拡大の中で最大限採算を維持・向上、BwithBの推進)

① Siウェハ向けポリッシャのシェア維持

- ・従来機に対し更なる生産性向上を実現する機種開発
- ・中国アフターサービスの充実
- ・東京テクニカルセンターの最大活用等

② 次世代機種の新規開発

- ・Siウェハ加工プロセス高度化対応、パワー半導体(SiC, GaN)、通信デバイス向(LT/LN)ウェハ対応のポリッシャ並びにグラインダの開発(競争力のある製品開発)、先端パッケージPLP(パネルレベルパッケージ)向けの加工装置

③ 東京テクニカルセンターの開設

- ・技術的な要求に対する実証試験を通じた受注確度の向上、並びにデモ機での設計・製造品質の作りこみ

④ 設計・製造キャパシティの強化

- ・投資含め、売上300億円を支える生産体制の構築
- ・九州テクニカルセンターによる売上拡大
- ・必要人員の増員、必要フロアの確保

半導体関連装置事業 ロードマップ

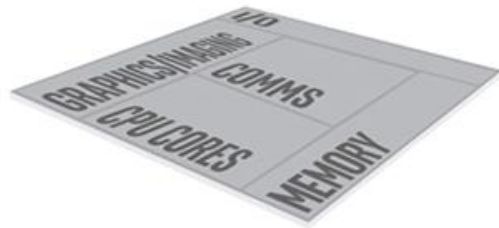
ショールーム・技術開発棟（東京テクニカルセンター）は2025年12月より運用開始
新機種開発と段階的な市場投入に注力



半導体関連装置事業 PLP

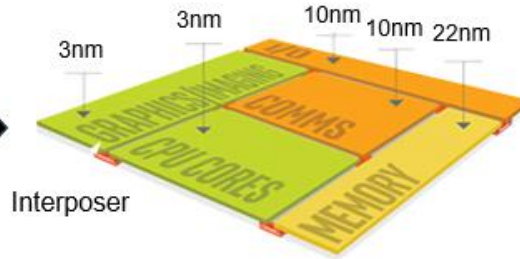
生成AIの登場が促すICパッケージング技術の変革 → PLP

一枚のシリコン基板上に集積



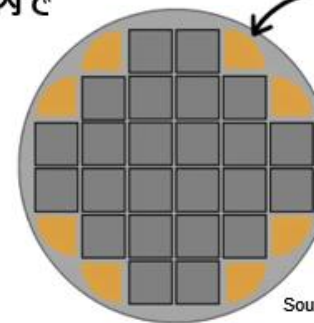
Monolithic Chips

複数の小さなチップ（チップレット）をパッケージ内で接続



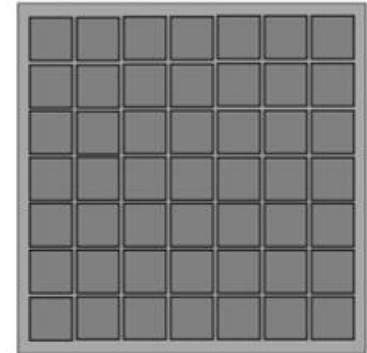
Chiplets

Source: パネルが変わる半導体製造: PLPという次の一手 / fukunishi

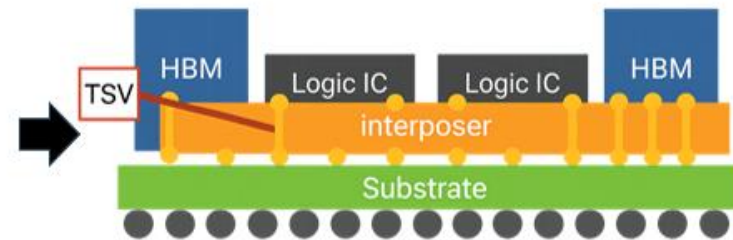
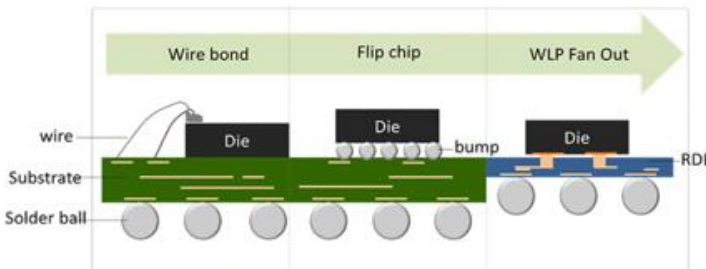


Source: Intel

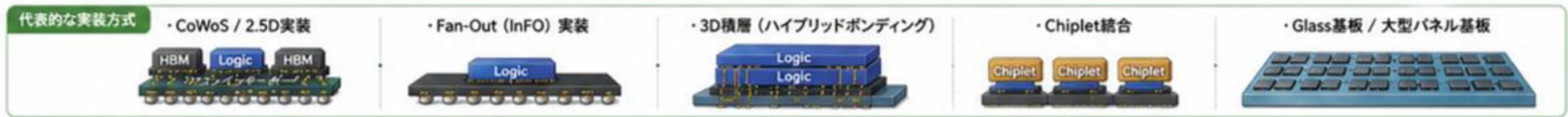
従来



PLP (Panel Level Package)



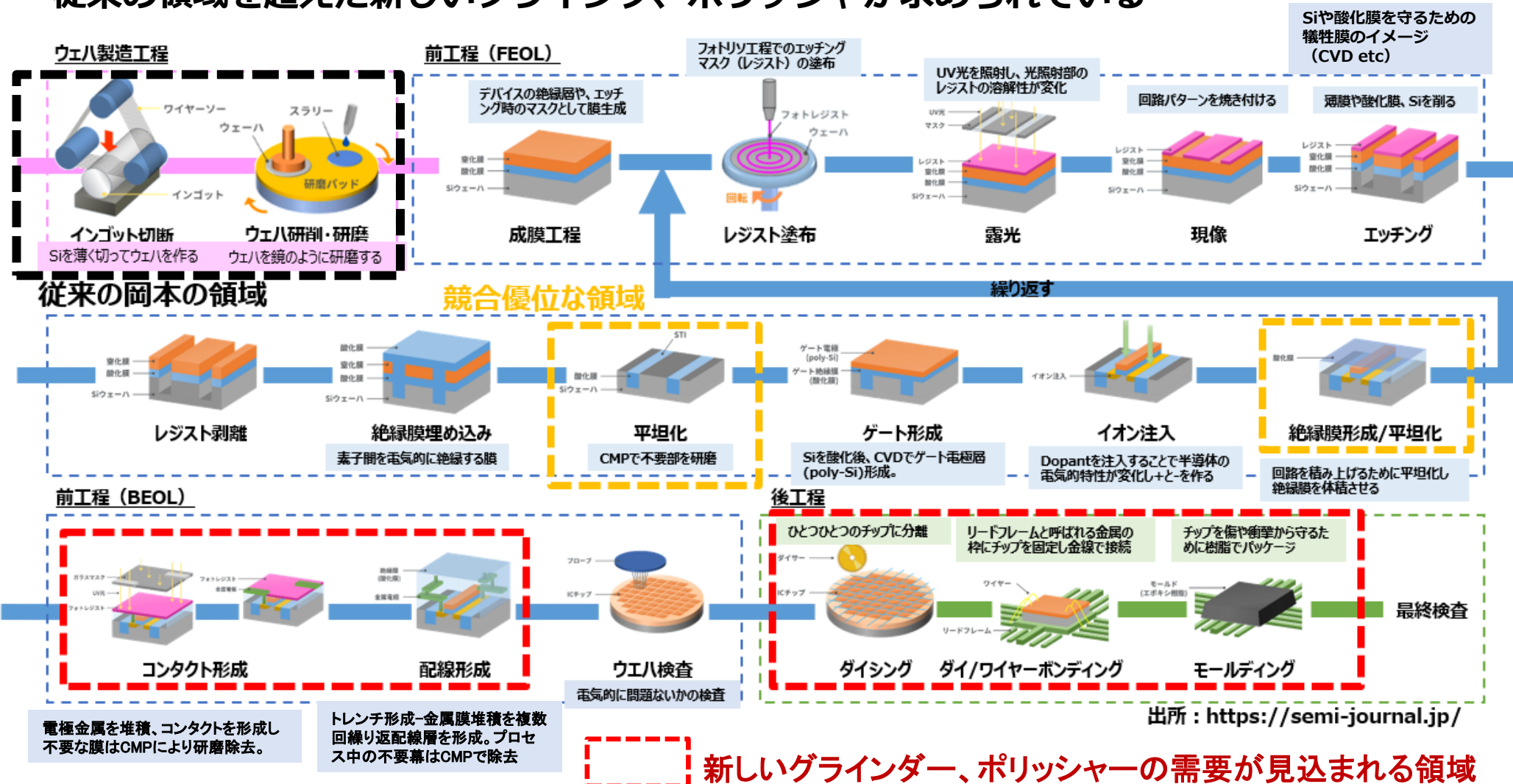
HBMメモリとロジックICをインターポザで接続し、TSVを介して基板に信号を伝達する,
source: Samsung Semiconductor



出所:生成AIにて作成

半導体関連装置事業 半導体製造工程の変化





従来の領域を超えた新しいグラインダ、ポリッシャが求められている



半導体関連装置事業

開発装置ラインナップ

デバイス工程への導入を考慮し自動搬送洗浄付きグラインダ、ポリッシャーを開発中

	GNX211/311	SVG401H	SPP1200	GNX1000	MNX300/400 シリーズ
外観				TBD	
TYPE	Grinder	Grinder	CMP	Grinder	Grinder CMP(TBD)
Φ200	○	○	○	○	○
Φ300	○	○	○	○	○
□300/310mm		○	○	○	○
515X510mm □600mm				○	TBD
搬送	手動	手動	自動	手動	自動
洗浄	—	—	—	—	○
	グラインダ	ポリッシャー	開発機		

半導体関連装置事業 東京テクニカルセンター

さいたま市に2025年12月、東京テクニカルセンターを開設、体制・人員を強化中



東京テクニカルセンター

1. 最新装置の紹介
2. テスト加工
3. 設計製造へのフィードバック
4. 長期耐久試験
5. 市場情報の収集の拠点に



1階ショールーム



1階VIPルーム



地下1階展示スペース



2階オフィスエリア

半導体関連装置事業

九州地区半導体関連拠点

生産体制強化

半導体産業の一大集積地となる九州で拠点を確保
計画に沿って生産体制を強化中

伊万里市
九州テクニカルサポートセンター



嘉島町
プレシード



都城市
大和工機

大型のクリーンルームを活用し、
高硬度材向けグラインダーの生産体制を構築中

2023年5月 九州テクニカルサポートセンター開設

2023年5月 プレシード資本業務提携

2023年11月 大和工機 完全子会社化

工作機械事業 中計戦略骨子

工作機械

I. 成長市場での市場シェア拡大

(中国・アメリカでの売上拡大、インド市場開拓)

II. 工作機械事業の収益力改善

(機械本体収益改善、BwithB推進)

① 機械採算管理・売価見直し

グローバルでの機種別採算管理と、機種統合・再構築（値付け・開発含め）を推進。また、価値に応じた適正価格を追求

② コア機種拡販（海外/国内）

コア機種である平面研削盤を中心とした、北米・中国・インド展開。市場に適応した機種の拡販を進める

③ VE・設計標準化

過去の低採算機種の分析を踏まえ、標準化を徹底していく。また、新機種開発の中でVE推進し、既存機種へ展開しコスト低減を図る

④ 国内生産・サービス強化投資

生産革新（OPS・直送化等）による品質向上・コスト低減、自動倉庫投資含めたBwithBの推進

自動倉庫棟 完成

本社（安中）敷地内に懸案であった自動倉庫棟が2月に完成
部品の保管・入出庫・供給プロセスの最適化を実現し、迅速かつ安定したサービス提供が可能に



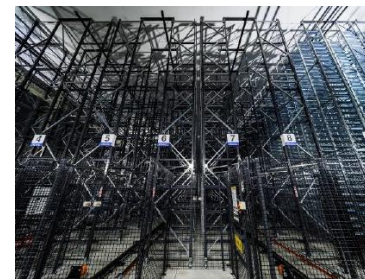
規模：地上3階建て（延べ床面積3,694.67㎡）
パレット2,496枚、バケット19,880個の収納が可能
屋根には太陽光発電設備を導入、環境負荷を低減

期待される効果：

- 保守部品の即納率向上
- 在庫管理の効率化
- 品揃え率向上によるリードタイム短縮
- 外部倉庫保有コスト削減
- 省人化の推進



詳細は
HPで動画で
視聴可能



<https://www.youtube.com/watch?v=mz2vinjDTVw>

【東南アジア・インド】

三井物産現地法人から大手日系ユーザなどを紹介され、営業活動を実施

【日本】

三井物産との連携を強化
大手ユーザーや
休眠ユーザーの
掘り起こしに注力

【北米】

Ellison を通じ営業販売エリアを拡大
顧客開拓進行中

<ご参考> 米Ellison Technologies, Inc.

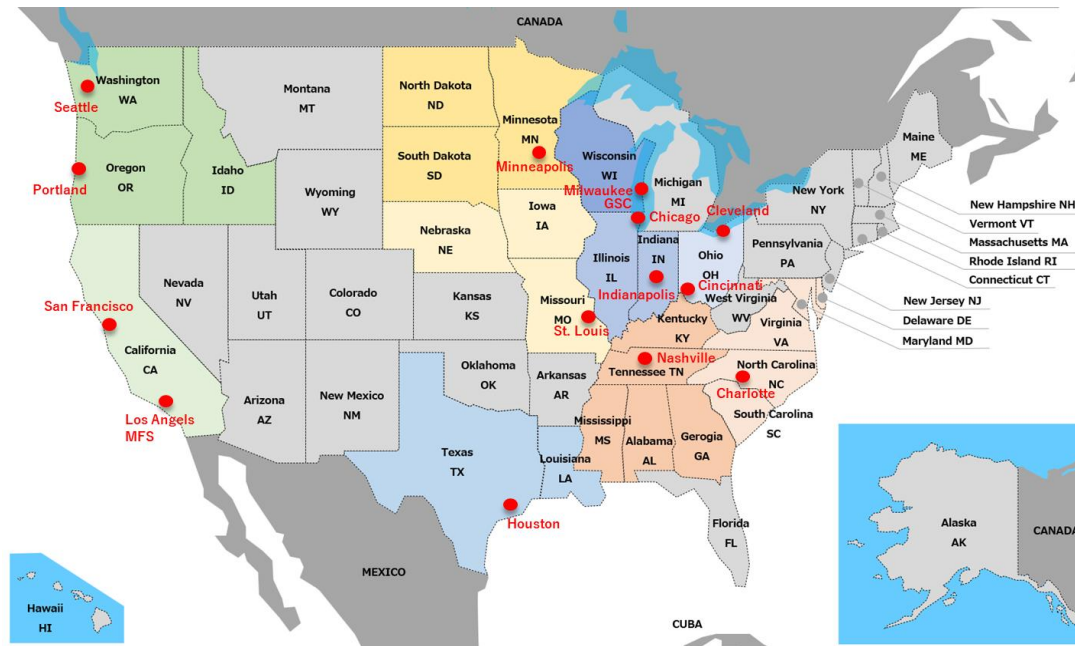
会社概要

会社名	Ellison Technologies, Inc. (略称: Ellison)
事業内容	工作機械等の販売及びサービス
創立	1955年
株主	三井物産100%

特徴

1. 工作機械の販売会社として全米最大手の一角
2. DNS代理店として世界No.2
3. 機械単体売りではなく、Turnkey Solutionを提供
4. 幅広い産業、大手から町工場までをカバー

販売地域 (26州で事業展開)



● Ellison支店所在地

出所：三井物産提供資料より



精密部品・素材（歯車・鋳物（外販））事業 中計戦略骨子

精密部品・素材 （歯車・ 鋳物（外販））

I. 歯車事業 安定収益体制構築

（事業の幅を横に広げながら、内製化推進・組織強化を図る）

II. 鋳物事業モノづくり改善/外販推進

（収益改善に向けた不良率低減・生産性の向上）

① 【歯車】 高付加価値製品の拡販

強みを生かした高付加価値製品の拡販/技術向上を通し、業界内でのポジションを高め、より安定した売上を確保できる体制を構築する

② 【歯車】 府中第二工場（新工場）での内製化推進

新工場投資により増加した生産キャパシティの有効活用（内製化） ・ 高い生産性の実現

③ 【歯車】 安定した収益を確保できる体制の構築

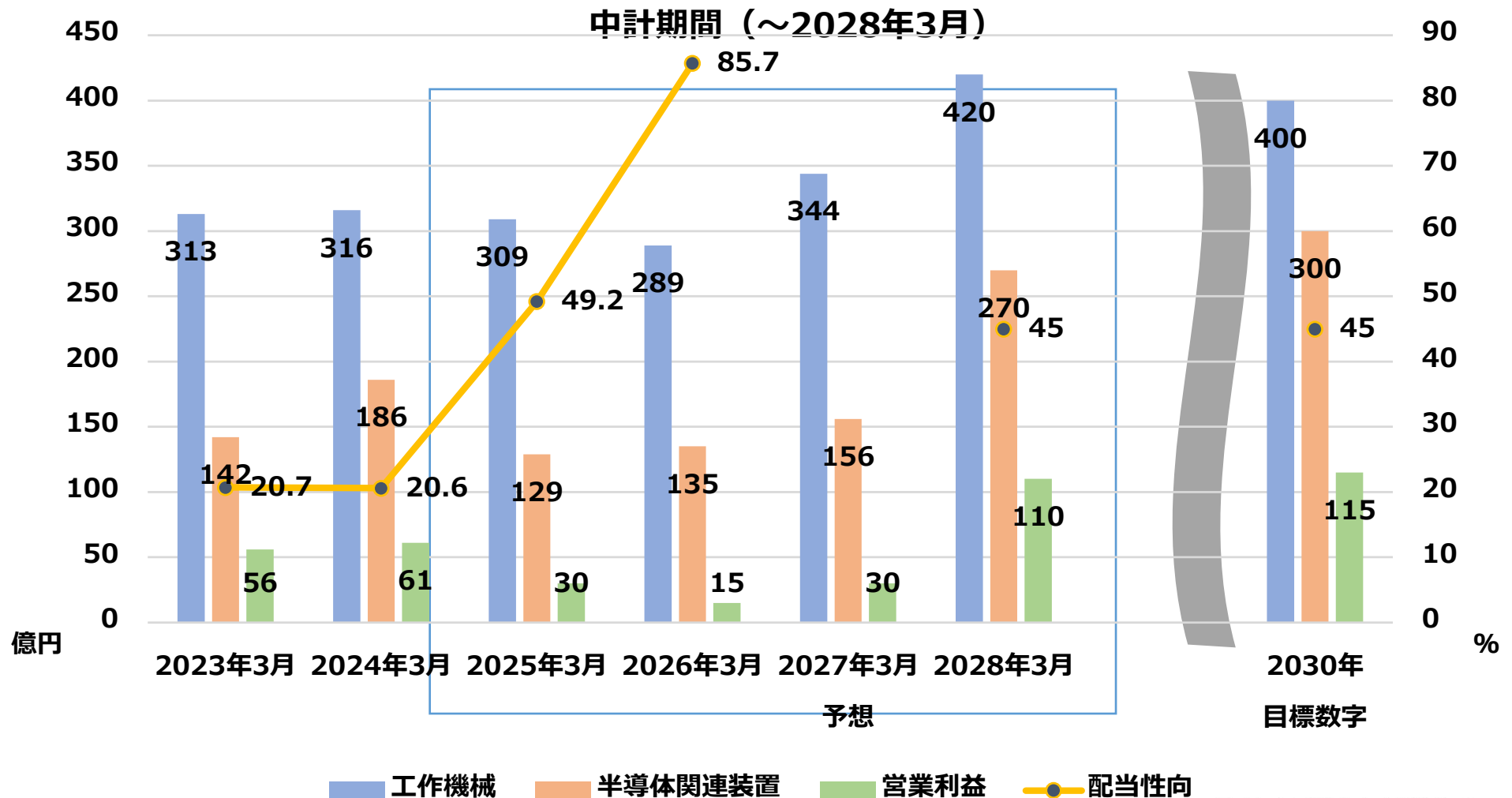
採算管理・計数管理体制の強化と、先回りした施策実行（価格コントロール等）

④ 【鋳物(外販)】 生産体制強化・外販推進

安定品質・安定生産を実現するための技能伝承及び、人員採用。特に木型の開発、生産技術のレベルを維持・向上させていく体制づくり/新規顧客の開拓による売上高の拡大（外販）

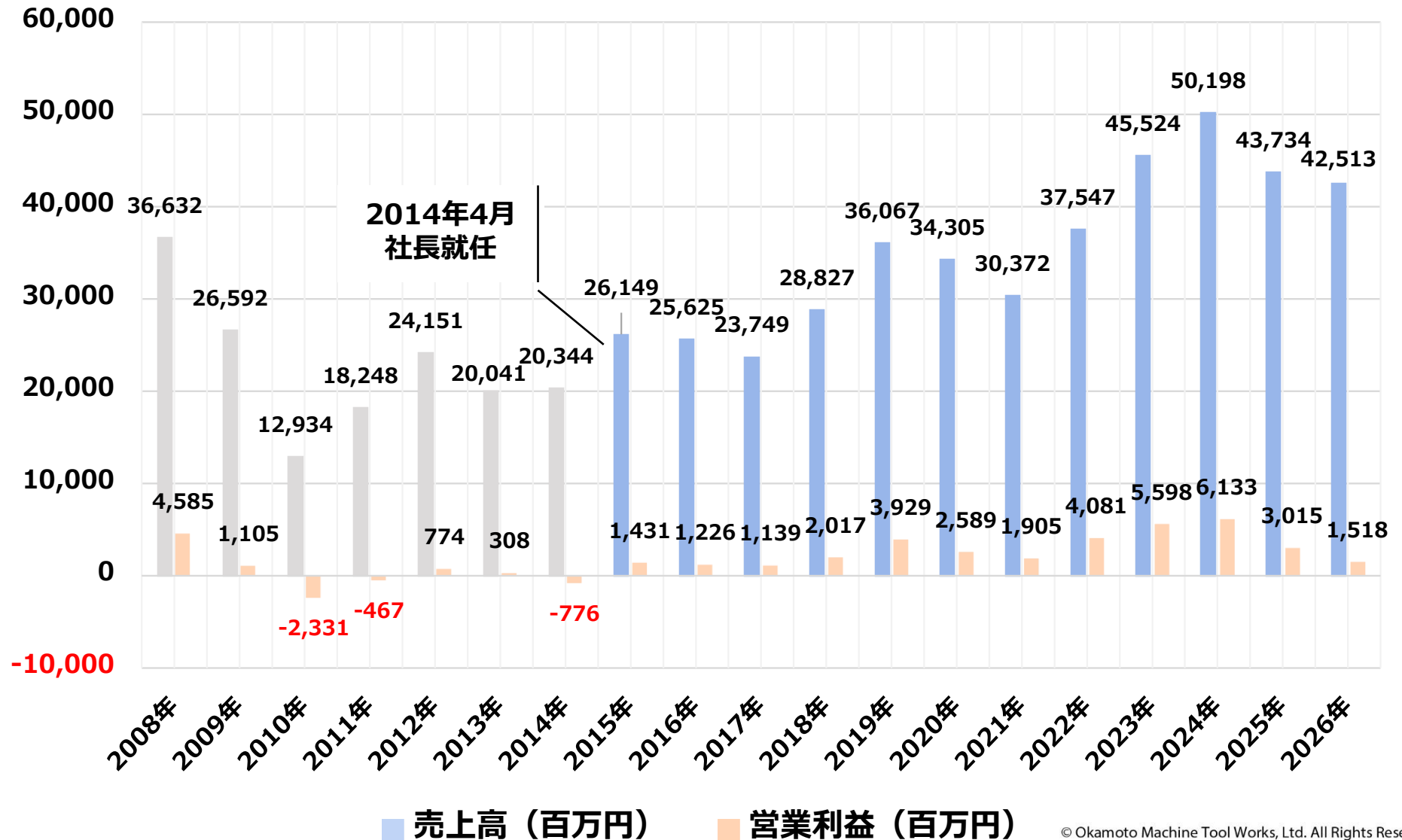
数値目標

米国通商政策や地政学的リスクの高まりなどから2026年3月期は足踏みしたものの、2028年3月期に「ビジョン2030」で掲げた数値目標水準への到達を目指す



代表交代にあたって

ビジョン2030に掲げた目標の達成を伊藤新社長に託す



Appendix (ご参考資料)

世界唯一の総合砥粒加工機メーカー

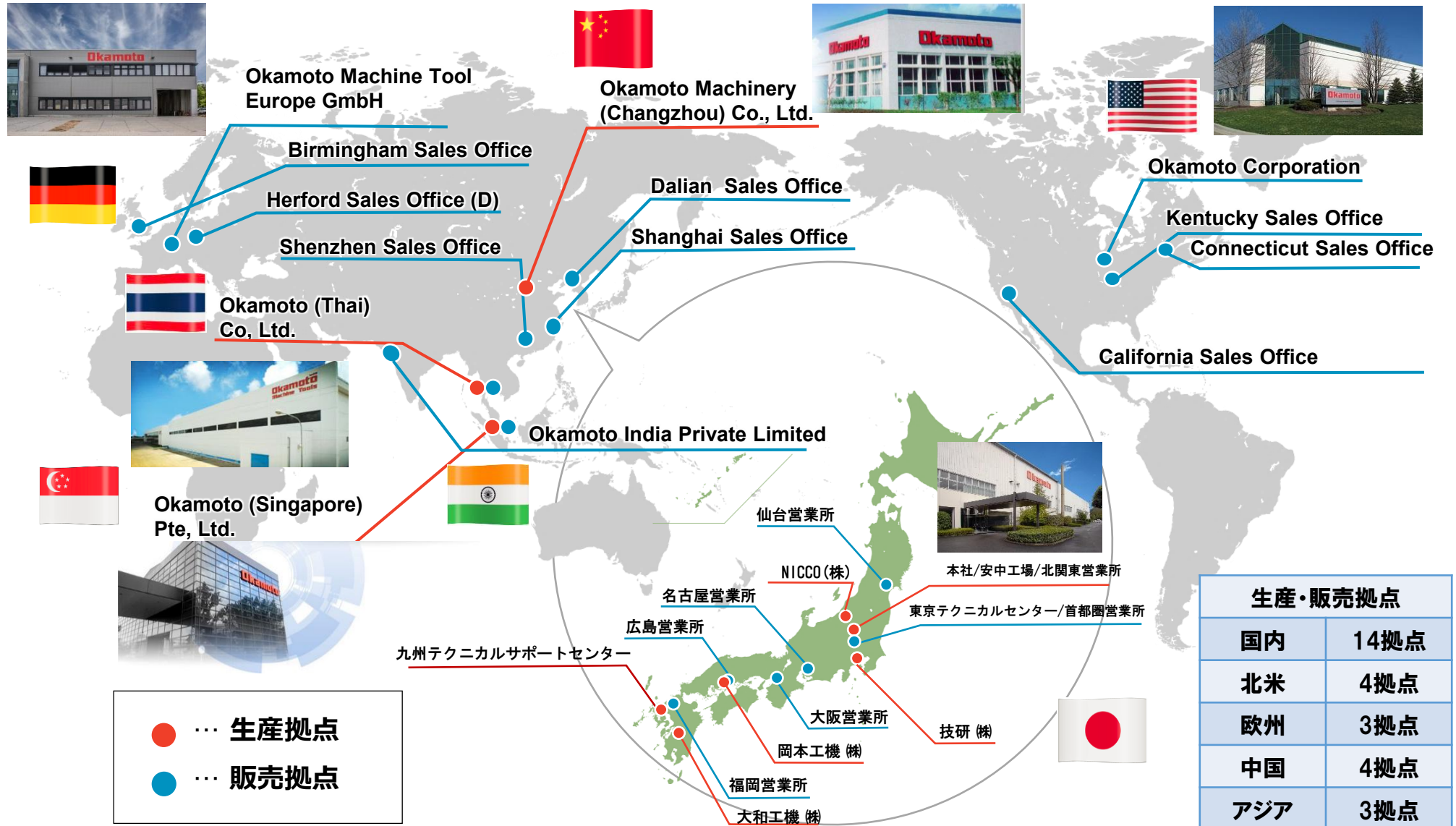


会社概要

会社名 英文	株式会社 岡本工作機械製作所 Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
創業	大正15年11月
設立	昭和10年6月
資本金	97億8,370万円
本社所在地	〒379-0135 群馬県安中市郷原2993番地
事業内容	【工作機械・半導体関連装置の製造・販売】 工作機械事業（平面研削盤・成形研削盤・内面研削盤・円筒研削盤・ 歯車研削盤・専用研削盤・精密歯車・鋳物） 半導体関連装置事業（グライディングマシン・スライディングマシン・ホーリングマシン・ラッピングマシン・ガラス基板研磨装置）
従業員数	連結: 2,229名 単体: 504名 ※2026年3月末現在



国内拠点、海外拠点



生産・販売拠点	
国内	14拠点
北米	4拠点
欧州	3拠点
中国	4拠点
アジア	3拠点

本資料に関するお問い合わせ先

株式会社 岡本工作機械製作所
総務部
TEL 027(385)5800

【本資料お取扱い上のご注意】

本資料は、株式会社岡本工作機械製作所(以下、当社)をご理解いただくため、当社が作成したもので、当社への投資活動勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するにあたっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果があります。